

# Technisches Datenblatt HPW-101Cp



## Norm

DIN EN 1044  
Din 8513  
EN ISO 3677

## Bezeichnung

CP101  
L-Ag18P  
B-Cu75AgP-645

## Zusammensetzung, Richtanalyse:

Ag	P	Cu
18,00%	7,00%	Rest

## Zulässige Verunreinigungen

Al	Bi	Cd	Pb	Zn	Gesamt
0,0100%	0,0300%	0,0500%	0,0100%	0,0500%	0,2500%

## Technische Angaben

Schmelzbereich

Solidus 645°C

Liquidus 645°C

Arbeitstemperatur 650°C

Dichte 8,4 g/cm<sup>3</sup>

Zugfestigkeit an CU: 250MPa

Dehnung ca. 10%

Warmfest bis ca. 150°C (ohne Festigkeitsabfall)

## Wärmequellen

Flammlötverfahren, Induktionserwärmung und Ofenlöten.

## Anwendungen

HPW-101Cp ist ein Phosphorhaltiges, niedrigschmelzendes Hartlot mit guten Fliesseigenschaften.

Es ist für Kupfer-Kupfer bzw. Verbindungen von Kupferbasiswerkstoffen geeignet. Durch den Phosphoranteil kann bei Kupfer-Kupfer-Verbindungen auf Flussmittel verzichtet werden. Für Schwefelhaltige Medien ist der Einsatz des Lotes nicht zulässig. Für Stähle (FE) und für Nickellegierungen ist dieses Lot aufgrund einer Sprödphasenbildung nicht geeignet. HPW-101Cp kann in der Kälteindustrie bis zu -50°C eingesetzt werden.

## Aufmachungen

Stäbe blank, Länge 500mm, Durchmesser 1,0; 1,5; 2,0; 3,0.

Draht Durchmesser 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 im Bund oder Spule D300.

Formteile und Folien auf Anfrage.